



|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| <b>Title of Change:</b>  | Die attach epoxy change from dispensing to CDAF   |                                       |
| <b>Proposed First Ship date:</b>   | 22 Mar 2021 or earlier if approved by customer  |                                       |
| <b>Contact Information:</b>  | Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:Naruedol.Srisamran@onsemi.com">Naruedol.Srisamran@onsemi.com</a>  |                                       |
| <b>PCN Samples Contact:</b>  | Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a> >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements. |                                       |
| <b>Additional Reliability Data:</b>  | Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:Lalan.Ortega@onsemi.com">Lalan.Ortega@onsemi.com</a>  |                                       |
| <b>Type of Notification:</b>   | This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a>                         |                                       |
| <b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b>   | There is no product marking change as a result of this change   |                                       |
| <b>Change Category:</b>  | Assembly Change   |                                       |
| <b>Change Sub-Category(s):</b>   | Material Change   |                                       |
| <b>Sites Affected:</b>   |   |                                       |
| <b>ON Semiconductor Sites</b>  | <b>External Foundry/Subcon Sites</b>  |                                       |
| None   | UTAC, Thailand  |                                       |
| <b>Description and Purpose:</b>  |   |                                       |
| ON Semiconductor would like to inform customers for the change in epoxy material including the process flow for support this material change as following table. The others material is the same : |   |                                       |
|  | <b>Before Change Description</b>  | <b>After Change Description</b>       |
| Die Attach   | ABLETHERM 8600  | CDAF515                               |
| Other Changes  | Dispensing epoxy at Die attach process  | DAF laminate before Wafer saw process |
| There is no product marking change as a result of this change.   |   |                                       |

**Reliability Data Summary:**QV DEVICE NAME: FDMC510P\_SN00292RMS: F65677PACKAGE: WDFN8

| Test      | Specification                   | Condition  | Interval  | Results |
|-----------|---------------------------------|--|-----------|---------|
| HTSL      | JESD22-A103                     | Ta = 150°C   | 1008 hrs  | 0 / 231 |
| IOL + PC  | MIL-STD-750 (M1037)<br>AEC-Q101 | Ta = +25°C, delta Tj=100°C<br>on/off = 2.5 min                         | 15000 cyc | 0 / 120 |
| TC + PC   | JESD22-A104                     | Ta = -65°C to +150°C   | 1000 cyc  | 0 / 231 |
| HAST + PC | JESD22-A110                     | Ta = 130°C, 85% RH, 18.8psig, bias                                     | 96 hrs    | 0 / 231 |
| AC + PC   | JESD22-A102                     | Ta = 121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased                                | 96 hrs    | 0 / 231 |
| PC        | J-STD-020; JESD-A113            | MSL 1 @ 260°C  |           | 0 / 924 |
| RSH       | JESD22- B106                    | Ta = 265C, 10 sec  |           | 0 / 30  |
| CDPA WP   | MIL 883E                        | Custom Destructive Physical Analysis – Wire Pull,<br>After TC and HTSL |           | 0 / 10  |
| PD        | JESD22-B100B                    | Physical Dimensions, Per Case outline                                  |           | 0 / 30  |

**Electrical Characteristics Summary:**

Electrical characteristics are not impacted.

**List of Affected Parts:**

**Note:** Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

| Part Number | Qualification Vehicle |
|-------------|-----------------------|
| FDM3622     | FDMC510P-SN00292      |
| FDMA1032CZ  | FDMC510P-SN00292      |
| FDMA410NZ   | FDMC510P-SN00292      |
| FDMC2523P   | FDMC510P-SN00292      |

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23682X

発行日: 15 Dec 2020

| 変更件名:   | ダイ接着をエポキシ分注から導電性ダイ接着フィルム(CDAF)に変更   |                                    |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
|---|---|------------------------------------|--|--------|--------|-------|----------------|---------|--------|--------------------|------------------------------------|
| 初回出荷予定日:  | 22 Mar 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.  |                                    |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| 連絡先情報:  | 現地のオン・セミコンダクター営業所または < <a href="mailto:Naruedol.Srisamran@onsemi.com">Naruedol.Srisamran@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。  |                                    |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| サンプル:   | 現地のオン・セミコンダクター営業所または < <a href="mailto:PCN.Samples@onsemi.com">PCN.Samples@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。<br>サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。<br>サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。                          |                                    |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| 追加の信頼性データ:  | 最寄りのオン・セミコンダクター営業所または < <a href="mailto:Lalan.Ortega@onsemi.com">Lalan.Ortega@onsemi.com</a> > にお問い合わせください  |                                    |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| 通知種別:   | これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。<br>オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、< <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> > 宛てにお願いします。 |                                    |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| 変更部品の識別:  | 今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。   |                                    |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| 変更カテゴリ:   | 組立の変更   |                                    |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| 変更サブカテゴリ:   | 材料の変更   |                                    |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| 影響を受ける拠点:   |   |                                    |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| オン・セミコンダクター拠点:  | 外部製造工場 / 下請業者拠点:  |                                    |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| なし  | UTAC, Thailand  |                                    |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| <p><b>説明および目的:</b></p> <p>オン・セミコンダクターは、以下の表に示すように、エポキシ材料の変更と、それに伴うプロセスフローの変更について、お客様にお知らせいたします。その他の材料に変更はありません。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダイ接着剤</td> <td>ABLETHERM 8600</td> <td>CDAF515</td> </tr> <tr> <td>その他の変更</td> <td>ダイ接着プロセスにおけるエポキシ分注</td> <td>ウェハソーイングプロセス前のダイ接着フィルム (DAF) ラミネート</td> </tr> </tbody> </table> <p>今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。</p> |   |                                    |  | 変更前の表記 | 変更後の表記 | ダイ接着剤 | ABLETHERM 8600 | CDAF515 | その他の変更 | ダイ接着プロセスにおけるエポキシ分注 | ウェハソーイングプロセス前のダイ接着フィルム (DAF) ラミネート |
|   | 変更前の表記  | 変更後の表記                             |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| ダイ接着剤   | ABLETHERM 8600  | CDAF515                            |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |
| その他の変更  | ダイ接着プロセスにおけるエポキシ分注  | ウェハソーイングプロセス前のダイ接着フィルム (DAF) ラミネート |  |        |        |       |                |         |        |                    |                                    |



## 最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23682X

発行日: 15 Dec 2020

## 信頼性データの要約:

デバイス名: FDMC510P\_SN00292RMS : F65677パッケージ: WDFN8

| テスト       | 仕様                              | 条件   | 間隔        | 結果      |
|-----------|---------------------------------|--|-----------|---------|
| HTSL      | JESD22-A103                     | Ta = 150°C   | 1008 hrs  | 0 / 231 |
| IOL + PC  | MIL-STD-750 (M1037)<br>AEC-Q101 | Ta = +25°C, delta Tj=100°C<br>on/off = 2.5 min                         | 15000 cyc | 0 / 120 |
| TC + PC   | JESD22-A104                     | Ta = -65°C to +150°C   | 1000 cyc  | 0 / 231 |
| HAST + PC | JESD22-A110                     | Ta = 130°C, 85% RH, 18.8psig, bias                                     | 96 hrs    | 0 / 231 |
| AC + PC   | JESD22-A102                     | Ta = 121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased                                | 96 hrs    | 0 / 231 |
| PC        | J-STD-020; JESD-A113            | MSL 1 @ 260°C  |           | 0 / 924 |
| RSH       | JESD22- B106                    | Ta = 265C, 10 sec  |           | 0 / 30  |
| CDPA WP   | MIL 883E                        | Custom Destructive Physical Analysis – Wire Pull,<br>After TC and HTSL |           | 0 / 10  |
| PD        | JESD22-B100B                    | Physical Dimensions, Per Case outline                                  |           | 0 / 30  |

## 電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

## 影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

| 部品番号       | 認定試験用ピークル        |
|------------|------------------|
| FDM3622    | FDMC510P-SN00292 |
| FDMA1032CZ | FDMC510P-SN00292 |
| FDMA410NZ  | FDMC510P-SN00292 |
| FDMC2523P  | FDMC510P-SN00292 |